



【0050/東京・長岡】先端半導体パッケージ向けソフトウェアエンジニア ◆東証プライム上場 / 半導体・電子デバイスの最先端技術企...

ウシオ電機株式会社での募集です。 組み込み・制御系のご経験のある方は歓迎です。

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

ウシオ電機株式会社

求人ID

1613887

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区

給与

500万円 ~ 900万円

勤務時間

08:45 ~ 17:15

休日・休暇

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 年間有給休暇14日～23日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります） ...

更新日

2026年09月17日 17:41

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

専門学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2410456】

～先端半導体パッケージ向けDLT装置のソフトウェア開発をご担当いただきます～

DLT装置の仕様決定において、顧客の要求事項を整理し、標準機能での対応可否や実現方法を確認します。

対応できない要望については要求仕様としてまとめ、協業先と実現方法を協議しながら仕様へ反映します。

顧客への機能説明、協業先との技術調整、実装された機能の妥当性確認、営業・社内技術部門との連携などを担当します。

顧客との技術打ち合わせや国内外への出張もあります。

※ソフトウェアのコーディング・実装は担当しません。

■この仕事の魅力

- ・ AI・HPC向け半導体を支える先端パッケージ用DLT事業に関われる
 - ・ 顧客要求の整理から要件定義、仕様策定まで、ソフトウェア上流工程の経験を積める
 - ・ 露光装置などの高度な生産設備に関する知識を身につけられる
 - ・ 顧客や協業先の技術部門と連携し、グローバルなプロジェクトを推進できる
 - ・ ソフトウェアと装置・生産技術の知識を組み合わせ、技術の幅を広げられる
- 顧客要求を整理し、生産設備として必要な要件・仕様を定義する上流工程が中心です。

スキル・資格

■必須要件

- ・ ソフトウェアの要件定義、仕様策定、仕様決定などの上流工程経験3年以上
 - ・ 顧客要求や関係者の要望を整理し、仕様書・要求事項としてまとめた経験
 - ・ ソフトウェアに関する基本的な知識
- ※ノーコードでの業務経験も含みますが、ソフトウェアの構造や仕様を理解できることを重視します
- ・ 英語での会話・読み書きに対応できる方
- ※TOEIC500点以上を目安とします
- ・ 技術的な内容について、英語で協業先と確認・調整できる方

■歓迎要件

- ・ 生産設備、製造装置、露光装置、精密機械、工作機械などに関する設計経験
- ・ 生産技術、設備技術、装置立上げなどの経験
- ・ 装置や設備における要求仕様・機能仕様の策定経験
- ・ 半導体製造装置、露光装置、アドバンストパッケージに関する知識
- ・ 顧客との技術折衝、要件定義、仕様変更管理の経験
- ・ 海外企業・海外技術部門との技術的な調整経験
- ・ 英語での技術会議、仕様書作成、メール対応の経験

会社説明

各種放電ランプ、ハロゲンランプ、レーザーなど光テクノロジーを利用した部品・装置の研究開発・製造